

Express5800/R120h-1M(2ndGen)スペック詳細

2019年05月31日 初版

フレームモデル

製品名称			Express5800/R120h-1M		
モデル名			8x 2.5型ドライブモデル	4x3.5型ドライブモデル	
製品型名			N8100-2773Y	N8100-2774Y	
CPU	Processor		インテル® Xeon® プロセッサ Bronze 3204(6C/6T, 1.90 GHz, 8.25MB, TDP 85W), Silver 4208(8C/16T, 2.10 GHz, 11MB, TDP 85W), Silver 4210(10C/20T, 2.20 GHz, 13.75MB, TDP 85W), Silver 4214(12C/24T, 2.20 GHz, 16.5MB, TDP 85W), Silver 4215(8C/16T, 2.50 GHz, 11MB, TDP 85W), Silver 4216(16C/32T, 2.10 GHz, 22MB, TDP 100W), Gold 5215(10C/20T, 2.50 GHz, 13.75MB, TDP 85W), Gold 5217(8C/16T, 3 GHz, 11MB, TDP 115W), Gold 5218(16C/32T, 2.30 GHz, 22MB, TDP 125W), Gold 5220(18C/36T, 2.20 GHz, 24.75MB, TDP 125W), Gold 5222(4C/8T, 3.80 GHz, 16.50MB, TDP 105W), Gold 6226(12C/24T, 2.70 GHz, 19.25MB, TDP 125W), Gold 6230(20C/40T, 2.10 GHz, 27.50MB, TDP 125W), Gold 6234(8C/16T, 3.40 GHz, 24.75MB, TDP 130W), Gold 6238(22C/44T, 2.10 GHz, 30.25MB, TDP 140W), Gold 6240(18C/36T, 2.60 GHz, 24.75MB, TDP 150W), Gold 6242(16C/32T, 2.80 GHz, 22MB, TDP 150W), Gold 6244(8C/16T, 3.60GHz, 24.75MB, TDP 150W), Gold 6248(20C/40T, 2.50 GHz, 27.50MB, TDP 150W), Gold 6252(24C/48T, 2.10 GHz, 35.75MB, TDP 150W), Gold 6254(18C/36T, 3.10 GHz, 24.75MB, TDP 200W), Platinum 8260(24C/48T, 2.40 GHz, 35.75MB, TDP 165W), Platinum 8268(24C/48T, 2.90 GHz, 35.75MB, TDP 205W), Platinum 8280(28C/56T, 2.70 GHz, 38.50MB, TDP 205W), Gold 5215M(10C/20T, 2.50GHz, 13.75MB, TDP 85W), Gold 6238M(22C/44T, 2.10GHz, 30.25MB, TDP 140W), Gold 6240M(18C/36T, 2.60GHz, 24.75MB, TDP 150W), Platinum 8260M(24C/48T, 2.40 GHz, 35.75MB, TDP 165W), Platinum 8280M(28C/56T, 2.70 GHz, 38.50MB, TDP 205W), Gold 5215L(10C/20T, 2.50GHz, 13.75MB, TDP 85W), Gold 6238L(22C/44T, 2.10GHz, 30.25MB, TDP 140W), Gold 6240L(18C/36T, 2.60GHz, 24.75MB, TDP 150W), Platinum 8280L(28C/56T, 2.70 GHz, 38.50MB, TDP 205W)		
		標準搭載数 / 最大搭載数	0/2		
		コントローラ・ハブとの接続	DMI3 (8GB/s)		
		インテル® 64	対応		
		インテル® パーチャライゼーション・テクノロジー	対応		
		インテル® ハイバースレディング・テクノロジー	対応 (Xeon Bronze 3204は除く)		
		インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー	対応 (Xeon Bronze 3204は除く)		
		CPUソケット形状	LGA3647		
		ホットプラグ	-		
		冷却方式	ファンなしヒートシンク		
チップセット			インテル® C621 チップセット		
メモリ		搭載容量 標準 / 最大	標準搭載なし(セレクトラブルオプション) / Registered DIMM : 1.5TB (24x 64GB), Load Reduced DIMM : 3TB (24x 128GB)		
		メモリソケット数	24		
		増設単位	1		
		搭載メモリ	DDR4-2933 Registered DIMM (8/16/32/64GB), DDR4-2933 Load Reduced DIMM (64/128GB)		
		最大動作周波数	2933MHz (CPU毎の最大動作周波数はシステム構成ガイドを参照願います)		
		メモリバス帯域(/チャネルあたり)	23.4GB/s		
		メモリアクセス方式	インディペンデントチャネルアクセス方式 (メモリ実装方法/BIOS設定に応じて12wayインターリーブをサポート)		
		誤り検出・訂正	ECC, x4 SDDC		
		メモリスベアリング	対応		
		メモリミラーリング	対応		
		ホットプラグ	-		
		モジュールピン数	288 ピン		
		動作電圧	1.2V		
		バッファ機能	対応		
補助記憶装置	ドライブベイ	内蔵スロット	フロント	8x2.5型ドライブ	4x3.5型ドライブ
			リア	2x2.5型増設ドライブ(オプション)	
		内蔵標準	1x2.5型ドライブ(オプション)		
			2x M.2 SATAスロット (オプション)		
		内蔵最大	-		
	2.5型HDD: SATA 22TB (11x 2TB), SAS 26.4TB (11x 2.4TB) 2.5型SSD: SATA 42.24TB (11x 3.84TB), SAS SSD: 21.12TB (11x1.92TB) (オプションHDDケージ追加時)				
	ホットスワップ	3.5型HDD : SATA 48TB(4x 12TB), ニアラインSAS 48TB(4x 12TB) + 2.5型HDD : SATA 2TB(1x 2TB), SAS 2.4TB(1x 2.4TB) 2.5型SSD : SATA 3.84TB(1x 3.84TB) (オプションHDDケージ追加時)			
	インターフェース規格とRAID構成		対応		
	光ディスクドライブ		SATA 6Gb/s : RAID 0/1/5/6/10/50/60 (オプション), SAS 12Gb/s : RAID 0/1/5/6/10/50/60 (オプション)		
	FDD		内蔵/外付ドライブ接続 (オプション) *1 オプション: Flash FDD (1.44MB) *2		
	拡張ベイ		-		
	拡張スロット	対応スロット	標準構成 1x PCI Express 3.0 (x16レーン, x16ソケット) (フルハイト、ハーフレングス) 1x PCI Express 3.0 (x8レーン, x8ソケット) (ロープロファイル、ハーフレングス) 1x PCI Express 3.0 (x8レーン, x8ソケット) (RAIDコントローラ専用) 1x PCI Express 3.0 (x8レーン, x8ソケット) (LOMカード専用) (オプションのライザカードを手配することでPCI構成を変更可能です。詳細はシステム構成ガイドを参照ください。)		
			PCI Express 1.1, 2.0, 3.0		
グラフィックス	搭載チップ / ビデオRAM		マネージメントコントローラチップ内蔵 / 16MB		
	グラフィック表示 と 解像度		640x480, 800x600, 1,024x768, 1,280x1,024, 1,600x1,200, 1,920x1,200 1x USB3.0(Type A) *3, 1x USB2.0(Type A) (BMC用), 1xUSB2.0(Type A)(N8117-03 内蔵DVDドライブ増設キット 搭載時) 2x USB3.0 (TypeA) , 1xアナログRGB (ミニD-Sub15ピン), 1x マネージメント専用LANコネクタ (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応, RJ-45) 4x データLANコネクタ (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 (RJ-45)) 1x シリアルポート (オプション)		
標準インタフェース	リア	2x USB3.0 (TypeA), 2x SATA 3.0			
	内部	オンボード			
ネットワーク	実装形式	1x Broadcom® BCM5719			
	コントローラ	対応 (オプションボードとの組み合わせはシステム構成ガイドを参照願います)			
	チーミング	対応			
	FEC / GEC	対応 (Linuxの対応状況は、NECコーポレートサイトのLinuxドライバ情報をご参照ください)			
リモートマネージメント	ジャンボフレーム	PXEブート: 対応, iSCSIブート: 非対応			
	PXE / iSCSI ブート	BMC			
コントローラ		Marvell PHY			
マネージメント		対応			
WHEA(Windows Hardware Error Architecture)		オプション			
キーボード / マウス		System ROM U32 v2.02 (最新のバージョンはサポート情報のダウンロードサイトでご確認ください)			
BIOS Version (出荷当初)		01.40 (最新のリビジョンはサポート情報のダウンロードサイトでご確認ください)			
BMC Firmware Revision (出荷当初)		S0, S5			
System Sleep State		対応 (オプション、ホットプラグ可)			
冗長電源		対応 (標準、ホットプラグ可)			
冗長ファン		1Uラックマウント			
筐体デザイン		434.6mm x 707.0mm x 42.9mm (2.5 型ドライブモデル : フロントベゼル/ルール/突起物含まず) 434.6mm x 749.8mm x 42.9mm (3.5 型ドライブモデル : フロントベゼル/ルール/突起物含まず)			
外形寸法 (幅x奥行きx高さ)		14kg / 26kg (ケーブルアーム無し : 22kg)	14kg / 29kg (ケーブルアーム無し : 25kg)		
質量 (最小 / 最大)		選択必須オプション AC電源ユニット(N8181-160) 800W 80 PLUS® Platinum 取得電源 (二極並行アース付きコンセント) (ホットプラグ可) (最大 : 2) AC100-120V/200-240V±10%, 50/60Hz±3Hz (電源ケーブルは必須選択オプション) AC電源ユニット(N8181-161, 162) 800W 80 PLUS® Titanium/1600W 80 PLUS® Platinum 取得電源 (二極並行アース付きコンセント) (ホットプラグ可) (最大 : 2) AC200-240V±10%, 50/60Hz±3Hz (電源ケーブルは必須選択オプション) DC電源ユニット(N8181-163) 800W DC-48V 電源 (二極並行アース付きコンセント) (ホットプラグ可) (最大 : 2) (電源ケーブルは必須選択オプション) *10			
電源	消費電力(100V最大構成時,最大電力)		908VA / 899W (800W 電源最大値) *7		
	消費電力(200V最大構成時,最大電力)		1075VA / 1072W *7		
	発熱量		4241KJ/h		
	省エネ法(2011年度基準)に基づくエネルギー消費効率		対象外		
音量	音圧レベル (待機時 / 高負荷時) *4	35.9dBA / 45.1dBA			
測定方式		ISO7779基準, 傍観者位置測定 (床上: 1.5m, サーバとの距離: 1m), サーバ設置(床上: 0.75m), 環境温度23℃ 動作時: 10～35℃(条件付きで5～40℃/45℃対応可) *11, 保管時: -30～60℃ 動作時: 8～90%, 保管時: 5～95% (動作時/保管時ともに結露しないこと)			
温度条件		VCCI クラス A			
湿度条件		Windows Logo Program, Red Hat Certified Hardware			
ハードウェア認証規定		スタートアップガイド, 保証書, フロントベゼル			
OS認証		3年オンサイト保守サービス(月～金, 9:00～18:00, 翌営業日対応, 国民の祝日および年末年始等のNEC指定日を除く) 3年パーツ保証			
主な添付品		-			
無償保証内容		Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Standard, Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Datacenter, Microsoft® Windows Server® 2016 Standard, Microsoft® Windows Server® 2016 Datacenter, Microsoft® Windows Server® 2019 Standard , Microsoft® Windows Server® 2019 Datacenter , Red Hat® Enterprise Linux® 7.6 *5, VMware ESXi™ 6.5 Update2, VMware ESXi™ 6.7 Update2			
インストールOS		最新の動作確認情報は、情報発信サイト「Linux on Express5800」を参照願います			
サポートOS	NECサポート				
動作確認OS *6					

注意事項

拡張スロット 搭載可能なボードの奥行きはFull Height PCI: ロングサイズ = 312mm まで、ショートサイズ = 173.1mm まで Low Profile PCI: MD1 = 119.9mm まで、MD2 = 167.6mm まで を示します

注釈

- *1 内蔵DVD-ROMまたは内蔵DVDSuperMULTIを全システムに搭載しない場合、保守時およびOS再インストール時に備えて外付DVD-ROMをシステムで最低1式は必ず手配してください。
- *2 必要に応じて手配してください。主な用途については「Flash FDD製品概要と利用ケース」の構成ガイドを参照下さい。
- *4 特定構成(2xCPU(Xeon Gold 5118), 2x16GB DIMM, 1xRAIDコントローラ, 1xフレキシブルLOM, 標準ファン, 2x800W電源)での騒音値
- *6 BTOインストール不可。NECは動作確認情報のみ提供いたします。最新の動作確認情報は、情報発信サイト「Linux On Express5800」を参照願います。
- *7 CPU TDPごとの最大電力はシステム構成ガイド9.1.2をご参照ください。
- *8 本製品はお客様から提供を要求されている場合に限り、お客様へ販売することが認められています。
ご購入の際には、事前にお客様より Windows Server 2016 のライセンス条項に同意していただく必要があります。詳細はhttp://jpn.nec.com/windowsserver/2016/down.html をご覧ください。
- *10 DC-48V電源のほかDC380V電源を本装置で活用されたい方は、弊社営業まで別途お問い合わせください。
- *11 40℃/45℃環境においてそれぞれ構成制限及び環境制限があります。詳細は「リファレンス」の「40℃/45℃対応についての注意事項」をご参照ください。